

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-019

通富微电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,516,825,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 报告期内公司所处行业情况

2023 年，半导体市场经历了起伏，封测环节业务同样承压，特别是传统封测业务遭遇较大挑战。但从 2023 年下半年开始，半导体行业景气度逐步回升，消费电子产业链库存水平日趋降低，行业中有较强的补库存动力；同时，人工智能等技术的应用将成为行业增长的关键动能之一，半导体行业出现触底回升迹象。

1) 全球半导体市场触底回升

根据美国半导体行业协会(SIA)发布的报告显示，全球半导体行业 2023 年销售总额为 5,268 亿美元，与 2022 年 5,741 亿美元的总额相比下降了 8.2%，2022 年的销售数据已成为行业有史以来最高的年度总额。从区域来看，欧洲是 2023 年唯一实现年增长的区域市场，销售额增长 4.0%。所有其他区域市场的年销售额在 2023 年都有所下降：日本同比下降 3.1%、美洲同比下降 5.2%、亚太/所有其他地区同比下降 10.1%，中国同比下降 14.0%。

尽管 2023 年全球半导体销售额有所下滑，但在 2023 年下半年，这一数据有所回升：2023 年第四季度，全球半导体销售额为 1,460 亿美元，同比增长 11.6%，环比增长 8.4%；2023 年 12 月，全球半导体销售额为 486 亿美元，环比增长 1.5%。



SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示：“全球半导体销售在 2023 年初低迷，但在下半年强劲反弹，预计到 2024 年市场将实现两位数的增长。”根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的预测，2024 年，全球半导体市场将强劲增长，预计增长 13.1%。预计这一增长将主要由内存行业推动，该行业有望在 2024 年比上一年增长 40%以上。

2) 中国半导体市场呈现较强的发展韧性

2023 年中国半导体产业展现出较强的发展韧性。聚焦国内市场，2023 年中国半导体产业同样面临行业周期下行、市场低迷、贸易环境不稳定等多重考验，但国内庞大的市场表现出较强的发展韧性和潜力，产业规模持续扩大，产品技术创新能力显著提升，企业竞争力明显增强，产业高质量发展稳步推进。2023 年，我国集成电路产量 3,514 亿块，同比增长 6.9%。

中国半导体产业在技术创新、市场需求、产业生态系统、政策支持等多方面都具备良好的发展基础。中国作为全球最大的消费电子市场，对半导体产品的需求持续增长。随着物联网、5G、人工智能等新兴技术的快速发展，中国市场对于半导体产品的需求将会进一步增加，为中国半导体产业提供巨大的市场机遇。

3) 人工智能产业将成为未来大趋势

在政策引导、龙头企业积极部署、行业内在转型需求三大因素的驱动下，中国数字化转型市场快速增长，2023 年中国数字化转型支出规模达 2.3 万亿元。在算力领域，算力需求井喷式增长，预计到 2026 年，中国算力规模三年复合增长率将达到 20%。同时，随着“东数西算”工程实施持续深入，中国算力产业向“建好+用好”方向加速发展。

ADI 中国区销售副总裁赵传禹在接受《中国电子报》记者采访时表示，人工智能正以极快的步伐向边缘端发展，得益于自动驾驶和自动化工厂等新应用的出现，人们的目光转向高效率、实时决策和更安全可靠运行，进而带动数据管理和智能从云端移向边缘端，这一趋势也已蔓延到各个行业。

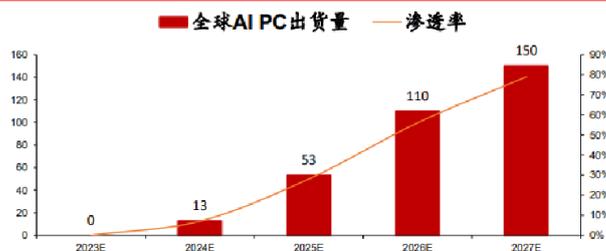
赛迪顾问在日前举办的“2024 年 IT 趋势发布会”上指出，我国人工智能产业将在未来 10 年至 15 年取得长足发展，多项产业要素全球领先。预计到 2035 年，中国人工智能产业规模将达 1.73 万亿元，全球占比超三成，为 30.60%。2024 年被视为 AI PC 元年，全球 AI PC 整机出货量预计将达到约 1300 万台。Dell’Oro 研究报告预计，2024 年 GPU 产值将继续同比激增 70%。

AI PC 核心特征



资料来源：AI PC 产业（中国）白皮书，上海证券研究所

全球 AI PC 出货量（百万部）



资料来源：群智咨询，上海证券研究所

4) 产业“强芯”政策确定发展目标

虽然集成电路行业出现了周期性起伏，但在行业春寒料峭之时，关于集成电路产业的利好政策纷纷传来。党的二十大报告提出，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。

山东、重庆、成都、苏州等地相继颁布了推动集成电路产业高质量发展的相关政策。山东省人民政府发布《关于加快实施“十大工程”推动新一代信息技术产业高质量发展的指导意见》提出，力争到 2025 年，全省集成电路产业规模过千亿元。重庆市人民政府印发的《重庆市集成电路设计产业发展行动计划（2023—2027 年）》提出，到 2027 年，重庆市集成电路设计产业营收突破 120 亿元，新增集成电路设计企业 100 家以上。苏州工业园区发布集成电路产业人才政策，针对创业领军、核心团队、中层骨干、青年紧缺等四大类集成电路人才，分别给予配套补贴、综合奖励、无忧落户、住房保障、子女教育等激励政策。

业内人士认为，地方密集出台相关产业政策，旨在为企业明确的发展方向和政策环境，吸引企业投资，推动集成电路产业链的完善和技术创新。

(2) 报告期内公司从事的主要业务

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。2023 年，半导体市场经历了起伏，公司努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

2023 年，公司扬长补短，积极调整产业布局，不断技术创新，加强管理，持续服务好大客户，苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在市场、人力、营运等各方面收获良好的效益。2023 年，公司实现营业收入 222.69 亿元，同比增长 3.92%。根据芯思想研究院发布的 2023 年全球委外封测榜单，在全球前十大封测企业 2023 年营收普遍下降的情况下，公司营收略有增长。

2023 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 1.69 亿元，同比下降 66.24%。由于报告期内，半导体市场经历了起伏，公司传统业务遭遇较大挑战，导致公司产能利用率及毛利率下降。同时，通富超威槟城为进一步提升市场份额，增加材料与设备采购，使得公司美元外币净敞口为负债，加之美元兑人民币汇率在 2023 年升值以及马来西亚林吉特对美元波动较大，使得公司产生汇兑损失，减少归属于母公司股东的净利润 1.90 亿元。如剔除该非经营性因素的影响，公司归属于母公司股东的净利润为 3.59 亿元，同比下降 28.49%。

2023 年，全体通富人接续奋斗、砥砺前行，经历了风雨洗礼，看到了美丽风景，取得了沉甸甸的收获。我们经受住了市场的风雨洗礼，释放出蓬勃发展新能量，展现出厚积薄发新景象。大家记住了一年的不易，也对未来充满信心。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	34,877,709,853.20	35,629,428,284.40	35,635,274,453.07	-2.13%	27,101,066,163.89	27,112,790,612.26
归属于上市公司股东的净资产	13,917,141,774.57	13,833,578,689.66	13,831,616,796.43	0.62%	10,441,986,798.89	10,440,197,245.46
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	22,269,283,210.86	21,428,576,599.20	21,428,576,599.20	3.92%	15,812,232,813.96	15,812,232,813.96
归属于上市公司股东的净利润	169,438,510.85	502,004,796.22	501,832,456.42	-66.24%	956,691,241.24	954,901,687.81
归属于上市公司股东的	59,483,489.2	356,601,140.	356,428,801.	-83.31%	796,207,650.	794,418,097.

司股东的扣除非经常性损益的净利润	3	86	06		80	37
经营活动产生的现金流量净额	4,292,652,175.28	3,197,950,182.76	3,197,950,182.76	34.23%	2,870,801,232.01	2,870,801,232.01
基本每股收益(元/股)	0.11	0.37	0.37	-70.27%	0.72	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.37	0.37	-70.27%	0.72	0.72
加权平均净资产收益率	1.22%	4.50%	4.50%	-3.28%	9.51%	9.51%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中第一项规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，该项解释内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,641,782,943.17	5,266,109,232.04	5,998,798,047.39	6,362,592,988.26
归属于上市公司股东的净利润	4,551,383.81	-192,245,382.79	124,027,514.31	233,104,995.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,702,339.41	-215,719,474.25	101,697,922.75	219,207,380.14
经营活动产生的现金流量净额	1,037,698,369.06	443,785,121.74	1,176,985,701.01	1,634,182,983.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末	121,710	年度报告	138,436	报告期末	0	年度报告披露日前一个	0
------	---------	------	---------	------	---	------------	---

普通股股东总数		披露日前一个月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数		月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	19.91%	301,941,893	0	质押	91,510,000	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	11.26%	170,817,547	0	不适用	0	
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	4.00%	60,614,848	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.00%	30,400,550	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	29,782,113	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.72%	26,021,036	0	不适用	0	
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	1.35%	20,519,835	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	19,956,873	0	不适用	0	

(LOF)						
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	17,948,048	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.09%	16,541,897	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东参与转融通业务的情况见下表。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	13,859,213	0.91%	4,459,100	0.29%	26,021,036	1.72%	776,600	0.05%
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	8,543,378	0.56%	2,750,000	0.18%	17,948,048	1.18%	32,300	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

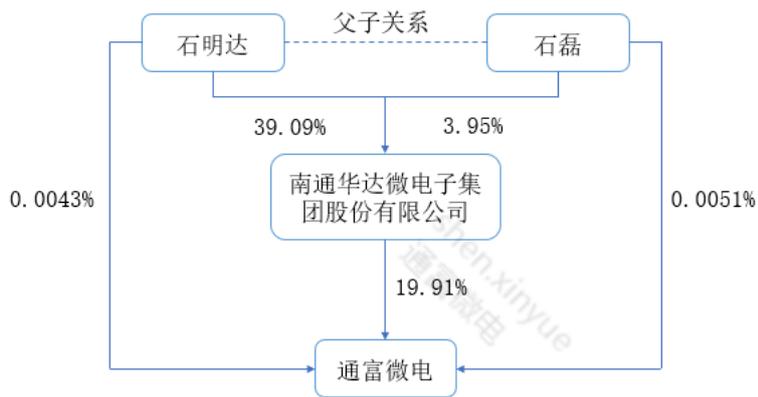
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	30,400,550	2.00%
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	19,956,873	1.32%
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	新增	32,300	0.00%	17,980,348	1.19%
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	16,541,897	1.09%
南通盛世金濠投资管理有限公司-南通盛富股权投资合伙企业(有限合伙)	退出	未知	未知	未知	未知
南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)	退出	未知	未知	未知	未知
天津金梧桐投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖信远金梧股权投资合伙企业(有限合伙)	退出	未知	未知	未知	未知
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品	退出	未知	未知	未知	未知

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

通富微电子股份有限公司

董事长：石磊

2023 年 4 月 11 日